



## Intel® Core™ i3-4370 Processor

4M Cache, 3.80 GHz

### *Niezbędne zasoby*

- Kolekcja produktów [Procesory Intel® Core™ i3 czwartej generacji](#)
- Nazwa kodowa [Nazwa Haswell poprzednich produktów](#)
- Segment rynku pionowego Desktop
- Numer procesora i3-4370
- Stan Discontinued
- Data rozpoczęcia Q3'14
- Przygotowanie do wycofania z produkcji 07/14/2017
- Litografia 22 nm
- Rekomendowana cena klienta \$138.00 - \$147.00

### *Wydajność*

- Liczba rdzeni 2
- Liczba wątków 4
- Bazowa częstotliwość procesora 3,80 GHz
- Cache 4 MB SmartCache
- Szybkość magistrali 5 GT/s DMI2
- TDP 54 W

### *Informacje uzupełniające*

- Dostępne opcje rozwiązań wbudowanych Nie
- Dane katalogowe [Wyświetl teraz](#)

### *Dane techniczne pamięci*

- Maks. wielkość pamięci (w zależności od rodzaju pamięci) 32 GB
- Rodzaje pamięci DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V
- Maks. liczba kanałów pamięci 2
- Maks. przepustowość pamięci 25,6 GB/s
- Obsługa pamięci ECC † Tak

### *Grafika wbudowana w procesor*

- Układ graficzny procesora † Grafika HD Intel® 4600
- Częstotliwość podstawowa układu graficznego 350 MHz
- Maks. częstotliwość dynamiczna układu graficznego 1,15 GHz
- Maks. pamięć wideo układu graficznego 2 GB
- Wyjście do grafiki eDP/DP/HDMI/DVI/VGA
- Maks. rozdzielczość (HDMI 1.4) ‡ 4096x2304@24Hz
- Maks. rozdzielczość (DP) ‡ 3840x2160@60Hz
- Maks. rozdzielczość (eDP – wbudowany płaski wyświetlacz) ‡ 3840x2160@60Hz
- Maks. rozdzielczość (VGA) ‡ 1920x1200@60Hz

- Obsługa DirectX\* 11.1/12
- Obsługa OpenGL\* 4.3
- Intel® Quick Sync Video Tak
- Technologia Intel® InTru™ 3D Tak
- Technologia Intel® Clear Video HD Tak
- Liczba obsługiwanych wyświetlaczy † 3
- Identyfikator urządzenia 0x412

## ***Opcje rozszerzeń***

- Skalowalność 1S Only
- Wersja PCI Express Up to 3.0
- Liczba konfiguracji PCI Express † Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4
- Maksymalna liczba linii PCI Express 16

## ***Specyfikacja obudowy***

- Obsługiwane gniazda FCLGA1150
- Maks. konfiguracja procesora 1
- Specyfikacja systemu Thermal Solution PCG 2013C
- T<sub>CASE</sub> 66.4°C
- Wymiary obudowy 37.5mm x 37.5mm

## ***Technologie zaawansowane***

- Technologia Intel® Turbo Boost † Nie
- Intel® vPro™ — kryteria kwalifikowalności platformy † Nie
- Technologia Intel® Hyper-Threading † Tak
- Technologia Intel® Virtualization (VT-x) † Tak
- Technologia Intel® Virtualization for Directed I/O (VT-d) † Nie
- Technologia Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) † Tak
- Intel® TSX-NI Nie
- Intel® 64 † Tak
- Zestaw instrukcji 64-bit
- Rozszerzony zestaw instrukcji Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2
- Stany bezczynności Tak
- Udoskonalona technologia Intel SpeedStep® Tak
- Technologie monitorowania chłodzenia Tak
- Program stabilnych platform firmy Intel® ułatwiających pracę administratorom Nie

## ***Niezawodność i bezpieczeństwo***

- Intel® AES New Instructions Tak
- Secure Key Tak
- Technologia Intel® Trusted Execution † Nie
- Funkcje Execute Disable Bit † Tak